

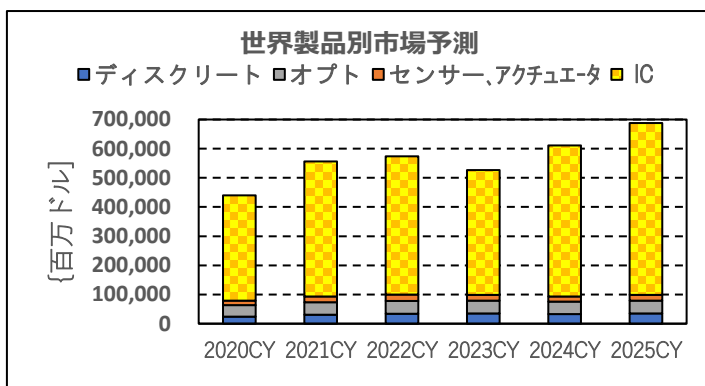
今回は、半導体市場関連のニュースをお伝えします。

半導体市場 25年も最高予測 (AI需要旺盛)

半導体の主要メーカーでつくる世界半導体市場統計(WSTS)は6月4日、2025年の市場規模が前年比12.5%増の6,873億ドル(約107兆円)になるとの予測を発表しました。人工知能(AI)向けの需要が旺盛で、過去最高を更新することです。23年は世界的な半導体不況で、AIや自動車関連を除くと低調に推移し、前年比8.2%減の5,268億ドルに終わりました。これに対し、24年は市況が回復。データ保存に使うメモリーと、演算や画像処理を担うロジック半導体の一部が急拡大しているようです。市場予測を前回の13.1%増から16.0%増(6,112億ドル)に上方修正しました。25年はこの流れを引き継ぎ、2年連続で市場が拡大すると見通しました。25年を地域別で見ると、米国が14.8%増と最も成長率が高く、アジア太平洋地域(12.3%増)が続きます。日本は電気自動車(EV)向けの需要が回復する見込みで、9.3%増の7兆5,088億円と予測しました。

[製品別市場動向 (世界市場)]

2024年における製品別のドルベースでの市場は、ディスクリートは前年比-7.8%、オプトは同-1.0%、センサー & アクチュエーターは同-7.4%、IC全体は同+20.8%と予測しました。25年には、ディスクリートは前年比+7.7%、オプトは同+3.5%、センサー & アクチュエーターは同+6.3%、IC全体は同+13.7%と予測しました。



	24年の予測		25年の予測	
	前年比 (%)	市場規模 (億ドル)	前年比 (%)	市場規模 (億ドル)
ディスクリート	-7.8	328	+7.7	353
オプト	-1.0	427	+3.5	442
センサー、アクチュエーター	-7.4	183	+6.3	194
IC全体	+20.8	5,175	+13.7	5,884
メモリー	+76.8		+25.2	
ロジック	+10.7		+10.4	
マイクロ	+1.6		+5.2	
アナログ	+2.7		+6.7	

トピックス (新聞記事より)

◆ラピダス

次世代半導体の国産化を目指すラピダス社は、回路線幅が2ナノメートル相当の先端半導体の量産技術に関するパートナーシップを米IBMと締結したと発表しました。IBMからノウハウの提供を受け、2027年の量産開始に向け技術確立を急ぎます。両社は既に先端半導体の共同開発でパートナーシップを締結しており、今回の提携は、製造工程のうち半導体基板をパッケージに収める「後工程」の技術などが対象で、量産の鍵となります。ラピダス社は政府の支援を受けて北海道千歳市に新工場を建設し、25年4月には試作ラインを稼働させる予定です。

◆鴻海(ホンハイ)

シャープの親会社の台湾・鴻海(ホンハイ)精密工業は、米半導体大手NVIDIAと協力し、台湾南部・高雄に人工知能(AI)関連の開発などを行う施設「先端コンピューティングセンター」を設立すると発表しました。26年までに完成させる予定。同施設ではNVIDIAの画像処理装置(GPU)の先端品を導入します。鴻海はNVIDIAの強大なAI技術を活用し、スマートEV(電気自動車)やスマートシティー分野の発展を目指すとしています。

◆シャープ

シャープ、KDDI、Super Micro Computer、データセクションの4社は、アジア最大規模のAIデータセンター構築に向け協議を開始することに合意しました。今後、シャープ堺工場跡地にNVIDIAの最先端のAI計算基盤「GB200 NVL72」などを搭載したAIデータセンターを構築し、早期に稼働開始することを目指して協議を開始します。

◆TSMC

台湾積体回路製造(TSMC)の5月の売上高は、前年同月比30%増の2,296億台湾ドル(約1兆1,000億円)となりました。旺盛なAI需要と一部家電の回復が寄与しました。米マイクロソフトやオープンAIなどを顧客に持つNVIDIA向けに半導体を生産する同社は、世界的なAIサービス開発競争から恩恵を受けています。スマートフォンの世界販売が今年1-3月期に長年の低迷から脱し、モバイル向け半導体の好調な受注への期待も高まっています。また、3ナノメートル製造プロセスは、米アップルやNVIDIAなど主要顧客7社が生産能力を全数確保し、2026年まで受注が満杯と伝えられています。